

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第1区分
 【発行日】平成19年2月1日(2007.2.1)

【公開番号】特開2005-181222(P2005-181222A)

【公開日】平成17年7月7日(2005.7.7)

【年通号数】公開・登録公報2005-026

【出願番号】特願2003-425616(P2003-425616)

【国際特許分類】

G 01 R 31/26 (2006.01)

【F I】

G 01 R 31/26 H

【手続補正書】

【提出日】平成18年12月6日(2006.12.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

以下の工程を含む半導体装置の製造方法：

(a) 複数の半導体装置が搭載された複数のテストボードが恒温槽に導入されてテストが行われている状態で、テストが終了した1枚の前記テストボードを取り出す工程；
 (b) 取り出された前記テストボードから、前記複数の半導体装置をはずす工程；
 (c) 前記半導体装置をはずした前記テストボードに、テストする複数の半導体装置を搭載する工程；
 (d) 前記複数の半導体装置が搭載された前記テストボードを前記恒温槽に導入し、前記導入したテストボードをテストする工程。

【請求項2】

請求項1記載の半導体装置の製造方法において、

前記複数のテストボードが前記恒温槽に導入されて前記複数の半導体装置のテストが行われている状態で、新たにテストされる複数の半導体装置を前記テストボードに搭載する工程と、

テストが終了した前記テストボードが前記恒温槽から取り出された際に、前記新たにテストされる半導体装置が搭載されたテストボードを前記恒温槽に導入し、テストする工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項3】

請求項2記載の半導体装置の製造方法において、

前記恒温槽は、第1のスロットと第2のスロットとの温度が異なる半導体装置の製造方法。

【請求項4】

請求項1記載の半導体装置の製造方法において、

第1の温度が設定された前記恒温槽において前記テストボードに搭載された半導体装置のテストを行う工程と、

前記第1の温度によるテストが終了した後、第2の温度が設定された前記恒温槽において前記テストボードに搭載された半導体装置のテストを行う工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項5】

請求項 4 記載の半導体装置の製造方法において、
前記恒温槽を第1の温度に設定し、前記半導体装置をテストする工程と、
前記第1の温度によるテストが終了すると、前記恒温槽を第2の温度に設定し、前記半導体装置をテストする工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

請求項 5 記載の半導体装置の製造方法において、
第1の温度による前記半導体装置のテストと第2の温度による前記半導体装置をテストと異なる恒温槽により行う半導体装置の製造方法。

【請求項 7】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、
ハンドラにより、前記テストボードに半導体装置を搭載する工程と、
前記半導体装置を搭載したテストボードを1枚毎に前記検査装置の恒温槽に前記ハンドラにより供給する工程と、
テストの終了後に、テスト結果に基づいて冷却された前記半導体装置を前記ハンドラにより分類、収納する工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 8】

請求項 7 記載の半導体装置の製造方法において、
前記ハンドラによって前記テストボードに搭載される半導体装置は、第1のテストボードと第2のテストボードで種類が異なる半導体装置の製造方法。

【請求項 9】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、
前記半導体装置は、ロジックや半導体メモリなどの複数の半導体チップを1つのパッケージに収納したS i P製品よりなる半導体装置の製造方法。